DENTAL BONDING AGENT

CLEARFIL™ Universal Bond Quick

CE 0197

NORSK BRUKSANVISNING

I. INTRODUKSJON

"CLEARFIL Universal Bond Quick" består av BOND og K-ETCHANT Syringe. BOND er et lysherdet bondingmateriale som muliggjør en samtidig behandling av dentin, emalje og protetiske materialer. Avhengig av indikasjon brukes BOND til Self-Etch-prosesser, eller med K-ETCHANT Syringe til selektiv emaljeetsing eller Total-Etch-prosesser. BOND er til bruk både for direkte og indirekte restaureringer. "CLEARFIL DC Activator" aktiverer den dobbeltherdende mekanismen i BOND. Ved bruk sammen med "CLEARFIL DC CORE PLUS" eller "PANAVIA SA Cement Plus" er det imidlertid ikke nødvendig å føye "CLEARFIL DC Activator" til adhesivet. BOND fås både som Bottle og som Unit Dose. K-ETCHANT Syringe er en etsegel som består av 35 % fosforsyre i vannholdig løsning og kolloidalt silisium.

II. INDIKASJONER

"CLEARFIL Universal Bond Quick" benyttes i følgende tilfeller:

[1] Direkte restaureringer med bruk av lysherdet komposittharpiks
[2] Kavitetsforsegling som forberedelse for indirekte restaureringer
[3] Behandling av synlig rotoverflate
[4] Behandling av hypersensible tenner
[5] Intraoral reparasjon av frakturerte restaureringer
[6] Feste av stifter og konusoppbygg
[7] Sementering av indirekte restaureringer

III. KONTRAINDIKASJONER

Pasienter med en historie med hypersensitivitet ovenfor metakrylat-monomerer og dette produktet

IV. MULIGE BIVIRKNINGER

[1] Munnslimhuden kan på grunn av koagulering av proteinet farges hvit ved kontakt med BOND. Her handler det om en forbigående tilstand som forsvinner i løpet av noen dager. Gjør pasienten oppmerksom på at området ikke bør irriteres under tannpuss.
[2] På grunn av den kjemiske sammensetningen kan K-ETCHANT Syringe fremkalle betennelse eller erosjon.

V. INKOMPATIBILITET

[1] Ikke bruk eugenolholdige materialer til vern av pulpa eller provisorisk forsegling, da eugenol kan forsinke herdingsprosessen.
[2] Ikke bruk hemostatika som inneholder jern. Disse materialene kan redusere adhesjonsevnen, og gjenværende jernioner kan forårsake misfarging av tannhalsen eller gingiva.
[3] Ved bruk av aluminiumkloridholdige blodstillende midler må mengden reduseres; unngå kontakt med den heftende flaten, ellers kan adhesjonsevnen på tannsubstansen eventuelt forringes.

VI. FORHOLDSREGLER

1. Sikkerhetsinstrukser

1. Dette produktet inneholder substanser som kan fremkalle allergiske reaksjoner. Ikke bruk produktet på pasienter med kjent overømfintlighet overfor metakrylatmonomerer eller andre komponenter.
2. Dersom pasienten viser tegn på overømfintlige reaksjoner, som utslett, eksem, betennelser, sår, hevelser, kløe eller nummenhet, skal produktet fjernes og ikke lenger brukes. Kontakt lege.
3. Påse at produktet ikke kommer i kontakt med huden eller øyet. Før produktet tas i bruk, skal pasientens øyne tildekkes med et håndkle for å beskytte dem mot sprut.
4. Dersom produktet kommer i kontakt med kroppsvev, skal følgende tiltak iverksettes:
   <Hvis produktet kommer i øyet>
   Skyll øyet omgående med mye vann og ta kontakt med lege.
   <Hvis produktet kommer i kontakt med hud eller munnslimhinne>
   Tørk straks av med en bomullsdott eller gasbind fuktet med alkohol og skyll grundig med mye vann.
5. Gå forsiktig frem for å forhindre at pasienten svelger produktet.
6. Unngå å se direkte inn i herdelyset når du herder BOND.
7. For å unngå krysskontaminering skal mengden av BOND som has i en fordypning på blandeplaten samt Unit Dose og applikatorbørsten ikke brukes til mer enn én pasient. Unit Dose og applikatorbørste er kun til engangsbruk. Kast dem etter bruk. Nålespissen er til engangsbruk. For å unngå krysskontaminering skal en spiss ikke brukes om igjen. Kast spissen etter bruk.
8. Bruk hansker eller iverksett andre vernetiltak for å forebygge overfølsomhet overfor metakryl-monomerer eller andre komponenter.
9. Avbryt bruken umiddelbart dersom det er skader på instrumenter som brukes til dette produktet.

2. Forholdsregler ved håndtering og manipulasjon

【Vanlige forhåndsregler】

1. Produktet må kun brukes til de formål som står oppført under [II.INDIKASJONER].
2. Dette produktet skal utelukkende brukes av tannleger.
3. I kaviteter i nærheten av pulpa eller ved utilsiktet pulpaeksponering skal det brukes et egnet preparat til tildekking.

【BOND】

1. BOND inneholder etanol, en brennbar substans. Må ikke brukes i nærheten av åpen ild.
2. For å unngå nedsatt virkeevne og håndtering er det viktig å følge de spesifikke herdetidene og andre krav angående påføring.
3. Rengjør kaviteten tilstrekkelig for å unngå mangler under bonding. Er det spytt eller blod på den heftende flaten, skal denne skylles grundig og tørkes før bonding.
4. **Bottle:** Bruk den lysblokkerende platen, slik at materialet ikke utsettes for behandlingslys eller omgivelseslys. Etter at materialet er trykket ut eller blandet, skal det brukes opp innen den bearbeidingstid som står angitt nedenfor.

Materiale	Bearbeidingstid
BOND	7 minutter
BOND + CLEARFIL DC Activator	90 sek.

Så snart etanolen i BOND fordamper, øker viskositeten, hvilket gjør påføringen vanskeligere.
Unit Dose: BOND skal påføres med applikatorbørsten umiddelbart etter at du har tatt hetten av beholderen.

5. Under påføringen av BOND på den heftende overflaten med gnidende bevegelse, flytt stedet som belyses ut av munnen eller slå den av for å unngå at den påførte BOND blir utsatt for behandlingslyset. Etter påføring av BOND skal det i tillegg så raskt som mulig tørkes tilstrekkelig til at BOND ikke flyttes av en mild luftstrøm.
6. BOND inneholder etanol og vann. "CLEARFIL DC Activator" inneholder etanol. Tørk hele den heftende flaten godt med en mild luftstrøm i mer enn 5 sekunder til BOND eller blandingen av BOND og "CLEARFIL DC Activator" ikke beveger seg mer. I motsatt fall vil adhesjonsevnen reduseres. For tilstrekkelig tørking må lufttrykket tilpasses formen og størrelsen på kaviteten og protesen. Bruk et sugeavtrekk for å forhindre at BOND eller blandingen renner utover.
7. Skulle behandlingsoverflaten være tilsmusset, skal den vaskes med vann, tørkes eller rengjøres med alkohol og behandles med BOND en gang til.
8. **Bottle:** BOND skal ikke blandes sammen med andre adhesjonsmidler (unntatt "CLEARFIL DC Activator").
   Unit Dose: BOND skal ikke blandes sammen med andre adhesjonsmidler. På grunn av utformingen til beholderen Unit Dose må ikke Unit Dose brukes med CLEARFIL DC Activator.
9. **Unit Dose:** Til bruk for kjerneoppbygging eller sementering skal BOND utelukkende brukes med "CLEARFIL DC CORE PLUS" eller med "PANAVIA SA CEMENT Plus".
10. **Bottle:** Lysherd blandingen av BOND og «CLEARFIL DC Activator». Ellers forkortes bearbeidingstiden drastisk.
11. **Bottle:** Lukk beholderen med en gang etter bruk, slik at fordampingen av det flyktige løsemiddelet (etanol i BOND) reduseres. Ikke trykk BOND ut av den lukkede beholderen med makt dersom væsken ikke flyter lett ut av dysen.
12. **Bottle:** Når BOND ikke har vært i bruk over lengre tid, kan det ev. hende at BOND ikke flyter lett. Rist beholderen før bruk.

【K-ETCHANT Syringe】

1. Påse at den ikke forurenses med spytt eller blod. Skulle behandlingsoverflaten være forurenset, må behandlingen utføres på nytt.
2. Vær påpasselig, slik at krysskontaminering unngås. Desinfiser sprøyten før og etter bruk ved å tørke av den med en bomullsdott med alkohol. Dekk sprøyten helt til med et engangstrekk av plast for å unngå forurensning med spytt eller blod.
3. Vask produktet av med vann hvis det blir hengende på klærne.
4. Ta nålespissen av sprøyten etter hver bruk og lukk sprøyten godt igjen med en gang.
5. Etsing av vital dentin kan føre til postoperativ sensitivitet.

【Dentalherdeenhet】

1. Lav lysintensitet gir dårlig adhesjon. Sjekk lampens driftstid og kontroller åpningen på dentalherdeenheten for smuss. Det anbefales å kontrollere dentalherdeenheten ved hjelp av et passende lysmåleapparat med jevne mellomrom.
2. Lysåpningen på dentalherdeenheten skal holdes så nært og loddrett til komposittharpiksoverflaten som mulig. Skal en store komposittharpiksoverflate herdes, anbefales det å dele området inn I flere avsnitt og å herde hvert avsnitt enkeltvis.

3. Forhåndsregler for lagring

1. Produktet må brukes før utløpsdatoen som er angitt på emballasjen.
2. BOND må avkjøles (2-8°C/ 36-46°F) når det ikke er i bruk, og bør varmes opp til romtemperatur mer enn 15 minutter før bruk. Etter at den er tatt ut av kjøleskapet, skal spesielt Bottle hvile til det har nådd romtemperatur, ellers kan overflødig væske sive ut, eller væsken kan renne ut etter bruk.
3. K-ETCHANT Syringe må oppbevares ved 2 - 25°C/ 36 - 77°F når det ikke er i bruk.
4. Beskyttes mot ekstrem varme, direkte sollys og ild.
5. Produktet må oppbevares trygt og kun tilgjengelig for tannpleiepersonale.

VII. KOMPONENTER

Vennligst se utsiden av pakken for Innhold og mengder.
<Hovedbestandeler>

1) BOND
   - 10-Methakryloyloxydecyldihydrogenfosfat
   - Bisfenol A diglycidylmethakrylat
   - 2-Hydroksyetylmetakrylat
   - Hydrofile amidmonomerer
   - Kolloidal silisium
   - Silanbondingmateriale
   - Natriumfluorid
   - dl-Camphorquinon
   - Etanol
   - Vann

2) K-ETCHANT Syringe
   - Fosforsyre
   - Vann
   - Kolloidal silisium
   - Pigment

3) Tilbehør
   - Applicator brush (fine <silver>) (Applikatorbørste <fine, sølv>)
   - Dispensing dish (Dispensertallerken)
   - Light blocking plate (Lysblokkerende plate)
   - Needle tip (E) (Nålespiss (E))

VIII. KLINISKE PROSEDYRER

A. Standardprosedyre I

[1] Direkte restaureringer med bruk av lysherdet komposittharpiks
[2] Kavitetsforsegling som forberedelse for indirekte restaureringer
[3] Behandling av synlig rotoverflate
[4] Behandling av hypersensible tenner

A-1. Isolering og fuktighetskontroll
For å oppnå best mulig resultat, må man unngå at kaviteten påvirkes av spytt og andre urenheter. For å holde tannen ren og tørr, anbefaler vi en kofferdam.

A-2. Forberede kaviteten eller rotoverflaten
Fjern det syke dentinet og forbered kaviteten på vanlig måte.
Rengjør rotoverflaten på normal måte ved behandling av hypersensible tenner. Skyll deretter grundig med vannspray og tørk med luft eller bomullspellets.

A-3. Pulpabeskyttelse
Hver direkte eller indirekte pulpaeksponering må dekkes med et fast herdende kalsiumhydroksidmateriale. Det er ikke nødvendig med sementunderlag eller -basis. Ikke bruk eugenolpreparater til å beskytte pulpa.

A-4. Forbehandling av tannen
Velg en av de tre etseprosessene før BOND påføres.
[MERKNAD]
Ved behandling av hypersensible tenner, velg det etterfølgende punkt A-4a før BOND påføres.

A-4a. Self-Etch-prosess
Fortsett med avsnitt A-5, uten å etse med K-ETCHANT Syringe.

A-4b. Selektiv emaljeetsing
Påfør K-ETCHANT Syringe på slipt og/eller uslipt emalje. La det virke i 10 sekunder, skyll og tørk.

A-4c. Total-Etch-prosess
Påfør K-ETCHANT Syringe på hele kaviteten (emalje og dentin), la den virke i 10 sekunder, og skyll og tørk deretter.

A-5. Applisering av BOND

1. **Bottle:** Umiddelbart før påføring has de nødvendige mengder BOND I fordypningen på dispensertallerkenen.
   [FORSIKTIG]
   Bruk den lysblokkerende platen, slik at materialet ikke utsettes for behandlingslys eller omgivelseslys. Bruk opp materialet innen 7 minutter etter at det er trykket ut.
   Unit Dose: Skru av hetten på beholderen.
   [FORSIKTIG]
   Ikke hold beholderen skrått når du tar av hetten, ellers kan det renne ut BOND.
2. Masser BOND med applikatorbørsten inn i hele kavitetsveggen. Ventetid er ikke nødvendig.
   [MERKNAD]
   Påse at behandlingsoverflatene ikke kommer i berøring med spytt eller eksudat.
3. Tørk hele kavitetsveggen godt med en mild luftstrøm i mer enn 5 sekunder til BOND ikke beveger seg lenger. Bruk et sugeavtrekk for å forhindre at BOND renner utover.
4. Lysherd BOND med en herdelampe (se tabellen "Herdelampe og herdetid").

Tabell: Herdelampe og herdetid

Type	Lyskilde	Lysintensitet	Herdevarighet
Halogen	Halogenlampe	Mer enn 400 mW/cm²	10 sek.
LED	Blå LED*	800 – 1400 mW/cm²	10 sek.
		Mer enn 1500 mW/cm²	5 sek.

Effektivt bølgelengdeområde for hver dentalherdeenhet må ligge på 400-515 nm.
* Toppen av utslippsspektrum: 450 - 480 nm

A-6. Sette inn kompositt-resin-restaureringsmaterialet eller behandle hypersensible tenner

A-6a. Direkte restaureringer med bruk av lysherdet komposittharpiks
Kompositten (f.eks. CLEARFIL MAJESTY ES-2, CLEARFIL MAJESTY ES Flow) has i kaviteten, lysherdes, pusses og poleres som beskrevet i produsentens anvisninger.

A-6b. Kavitetsforsegling og behandling av synlig rotoverflate
Påfør et tynt lag kompositt (f.eks. CLEARFIL MAJESTY ES Flow) på tannen og lysherd som beskrevet i produsentens anvisninger. Fjern upolymerisert kunststoff med en bomullsdott eller gasbind dyppet i alkohol.

A-6c. Behandling av hypersensible tenner
Fjern det upolymeriserte BOND-laget med en bomullsdott eller gasbind dyppet i alkohol.

B. Standardprosedyre II

[5] Intraoral reparasjon av frakturerte restaureringer

B-1. Forberede heftende flater
Gjør de heftende flatene ru med en diamantspiss eller ved å sandblåse dem med aluminiumoksidpulver (30 til 50 µm) med et lufttrykk på 0,1-0,4 MPa (14-58 PSI/ 1-4 kgf/cm²). Lufttrykket bør tilpasses materialet og/eller formen på protesen. Påse at denne ikke skaller av. Plasser dessuten en skråkant på kanten.

B-2. Behandling av heftende flater med K-ETCHANT Syringe
Påfør K-ETCHANT Syringe på den heftende flaten (inklusiv tannsubstans).
La det virke i 5 sekunder, skyll og tørk.

B-3. Påføring av BOND
Masser BOND inn i hele den heftende flaten. Se avsnitt A-5.
[MERKNAD]
For en optimal effekt FØR påføring av BOND, appliseres en silanbonding (f.eks. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS) i henhold til produsentens anvisninger på overflaten til glasskeramikken på silisiumdioksidbasis (f.eks. konvensjonelt porselen, litiumdisilikat) og en primer som hefter til metall (f.eks. ALLOY PRIMER) på overflaten inkl. edelmetall.

B-4. Sette inn restaurering av komposittharpiks
Kompositten (f.eks. CLEARFIL MAJESTY ES-2) has i kaviteten, lysherdes, pusses og poleres som beskrevet i produsentens anvisninger.
[MERKNAD]
Bruk en opak harpiks (f.eks. CLEARFIL ST OPAQUER) til å dekke over metallfargen før bruk av kompositt-kunststoffet.

C. Standardprosedyre III

[6] Feste av stifter og konusoppbygg
Ved bruk sammen med "CLEARFIL DC CORE PLUS" er det ikke nødvendig å bruke "CLEARFIL DC Activator".

C-1. Isolering og fuktighetskontroll
For å oppnå best mulig resultat, må man unngå at kaviteten påvirkes av spytt og andre urenheter. For å holde tannen ren og tørr, anbefaler vi en kofferdam.

C-2. Forberedelse av rotkanalen
Forbered og rengjør åpen rotkanalen på vanlig måte.

C-3. Forberedelse av stiften
Velg enten C-3a eller C-3b, avhengig av hvilken stift som brukes. Følg bruksinformasjonen for restaureringsmaterialet. Såfremt annet ikke er foreskrevet, gjelder følgende anbefaling:

C-3a. For glassfiberstifter
Påfør K-ETCHANT Syringe på stiftoverflaten. La den virke i 5 sekunder, skyll og tørk.
[FORSIKTIG]
- Ikke sandblås glassfiberstiftene med aluminiumoksidpulver, da dette kan føre skader på stiftene.
- Under forbehandlingen og fram til permanent pilaroppbygging må flatene som skal behandles ikke på noen måte kontamineres.

C-3b. For metallstifter
Sandblås den heftende flaten med aluminiumoksidpulver (30 til 50 µm) med et lufttrykk på 0,2-0,4 MPa (29-58 PSI/ 2-4 kgf/cm²). Lufttrykket bør tilpasses materialet. Etter sandblåsingen skal den protetiske restaureringen rengjøres med ultralyd i 2 minutter og deretter tørkes med luft.

C-4. Behandling av stiftoverflaten
Velg prosess avhengig av materialet som brukes.

C-4a. Ved bruk av CLEARIFL DC CORE PLUS

1. Umiddelbart før påføring has de nødvendige mengder BOND I fordypningen på dispensertallerkenen.
2. Påfør BOND med applikatorbørsten på hele stiftoverflaten.
3. Tørk hele den heftende flaten godt med en mild luftstrøm i mer enn 5 sekunder til BOND ikke beveger seg lenger. Bruk et sugeavtrekk for å forhindre at BOND renner utover.
   [MERKNAD]
   For tilstrekkelig tørking må lufttrykket tilpasses den heftende flatens form og størrelse.

C-4b. Ved bruk av et annet dobbelt-/selvherdende kunststoff-kjernemateriale eller en dobbelt-/selvherdende kunststoffsement

1. **Bottle:** Ha en dråpe BOND og en dråpe "CLEARFIL DC Activator" i en fordypning på blandeplaten og bland med applikatorbørsten.
   [FORSIKTIG]
   Bruk den lysblokkerende platen, slik at materialet ikke utsettes for behandlingslys eller omgivelseslys, og bruk opp materialet innen 90 sekunder etter blanding.
   Unit Dose: Kan ikke anvendes til denne bruk.
2. Påfør blandingen på stiftoverflaten.
3. Tørk hele den heftende flaten godt med en mild luftstrøm i mer enn 5 sekunder til blandingen ikke beveger seg lenger. Bruk et sugeavtrekk for å forhindre at blandingen renner utover.
   [MERKNAD]
   For tilstrekkelig tørking må lufttrykket tilpasses den heftende flatens form og størrelse.
4. Lysherd blandingen med en herdelampe (se tabell "Herdelampe og herdetid").
   [FORSIKTIG]
   Lysherdes blandingen ikke på stiften, forkortes bearbeidingstiden drastisk.

C-5. Forbehandling av tannen
Påfør K-ETCHANT Syringe etter behov. Se avsnitt A-4.

C-6. Bonding
Velg prosess avhengig av materialet som brukes.

C-6a. Ved bruk av CLEARIFL DC CORE PLUS

1. Umiddelbart før påføring has de nødvendige mengder BOND I fordypningen på dispensertallerkenen.
2. Masser BOND med applikatorbørsten inn i hele kavitetsveggen. Ventetid er ikke nødvendig.
   [MERKNAD]
   Påse at behandlingsoverflatene ikke kommer i berøring med spytt eller eksudat.
3. Tørk hele den heftende flaten godt med en mild luftstrøm i mer enn 5 sekunder til BOND ikke beveger seg lenger. Bruk et sugeavtrekk for å forhindre at BOND renner utover. Overskytende BOND fjernes med en papirspiss. Ved behov tørkes den heftende flaten på nytt etter at overskytende BOND er fjernet.
   [MERKNAD]
   For tilstrekkelig tørking må lufttrykket tilpasses den heftende flatens form og størrelse.
4. Lysherd BOND med en herdelampe (se tabell "Herdelampe og herdetid").

C-6b. Ved bruk av et annet dobbelt-/selvherdende kunststoff-kjernemateriale eller en dobbelt-/selvherdende kunststoffsement

1. Ha en dråpe BOND og en dråpe "CLEARFIL DC Activator" i en fordypning på blandeplaten og bland med applikatorbørsten.
   [FORSIKTIG]
   Bruk den lysblokkerende platen, slik at materialet ikke utsettes for behandlingslys eller omgivelseslys, og bruk opp materialet innen 90 sekunder etter blanding.
2. Masser blandingen med applikatorbørsten inn i hele kavitetsveggen. Ventetid er ikke nødvendig.
   [MERKNAD]
   Påse at behandlingsoverflatene ikke kommer i berøring med spytt eller eksudat.
3. Tørk hele den heftende flaten godt med en mild luftstrøm i mer enn 5 sekunder til blandingen ikke beveger seg lenger. Bruk et sugeavtrekk for å forhindre at blandingen renner utover. Overskytende blanding fjernes med en papirspiss. Ved behov tørkes den heftende flaten på nytt etter at overskytende blanding er fjernet.
   [MERKNAD]
   For tilstrekkelig tørking må lufttrykket tilpasses den heftende flatens form og størrelse.
4. Lysherd blandingen med en herdelampe (se tabell "Herdelampe og herdetid").
   [FORSIKTIG]
   Lysherdes blandingen ikke på rotkanalen, forkortes bearbeidingstiden drastisk.

C-7. Plassering av stift og pilaroppbygging
Plasser stiften og kjerneoppbyggingen med "CLEARFIL DC CORE PLUS" eller et annet kunststoff i henhold til produsentens anvisninger.

D. Standardprosedyre IV

[7] Sementering av indirekte restaureringer
Ved bruk sammen med "PANAVIA SA Cement Plus " er det ikke nødvendig å bruke "CLEARFIL DC Activator".

D-1. Forbehandling av overflaten på kavitet og pilar (tann, metall, kompositt)

1. Fjern provisorisk forseglingsmateriale og provisorisk sement på vanlig måte, rengjør kaviteten og hold den tørr.
2. Kontroller at restaureringen passer på kaviteten eller kjernen (tann, metall, kompositt). Ved bruk av en Try-in-pasta for kontroll av fargen er det viktig å følge produsentanvisningene.

D-2. Forberede overflaten på protetiske restaureringer
Velg enten D-2a eller D-2b, avhengig av restaureringen som brukes. Følg bruksinformasjonen for restaureringsmaterialet. Såfremt annet ikke er foreskrevet, gjelder følgende anbefaling:

D-2a. Til silisiumoksidbasert glasskeramikk (f.eks. konvensjonelt porselen, litiumdisilikat)
Etse glasskeramikkoverflaten med flussyre iht. produsentens anvisninger, og vask og tørk overflaten grundig.

D-2b. For metalloksider (f.eks. zirkonoksid), metaller eller kompositt-kunststoff
Sandblås den heftende flaten med aluminiumoksidpulver (30 til 50 µm) med et lufttrykk på 0,2-0,4 MPa (29-58 PSI/ 2-4 kgf/cm²) så den blir ru. Lufttrykket bør tilpasses materialet og/eller formen på den protetiske restaureringen. Påse at den ikke skaller av. Etter sandblåsingen skal den protetiske restaureringen rengjøres med ultralyd i 2 minutter og deretter tørkes med luft.

D-3. Forbehandling av protetiske restaureringer
Velg prosess avhengig av materialet som brukes.

D-3a. Ved bruk av PANAVIA SA Cement Plus

1. Umiddelbart før påføring has de nødvendige mengder BOND I fordypningen på dispensertallerkenen.
2. Påfør BOND med applikatorbørsten på hele den heftende flaten.
3. Tørk hele den heftende flaten godt med en mild luftstrøm i mer enn 5 sekunder til BOND ikke beveger seg lenger. Bruk et sugeavtrekk for å forhindre at BOND renner utover.
   [MERKNAD]
   - For tilstrekkelig tørking må lufttrykket tilpasses den heftende flatens form og størrelse.
   - For en optimal effekt påføres en silanbonding (f.eks. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS) i henhold til produsentens anvisninger på overflaten til glasskeramikken på silisiumdioksidbasis (f.eks. konvensjonelt porselen, litiumdisilikat) i stedet for BOND. Det er ikke nødvendig å påføre BOND på metalloksider eller metaller, da «PANAVIA SA Cement Plus» har sterk adhesjon til disse overflatene.

D-3b. Ved bruk av en annet dobbelt- eller selvherdende kunststoffsement

1. **Bottle:** Ha en dråpe BOND og en dråpe "CLEARFIL DC Activator" i en fordypning på blandeplaten og bland med applikatorbørsten.
   [FORSIKTIG]
   Bruk den lysblokkerende platen, slik at materialet ikke utsettes for behandlingslys eller omgivelseslys, og bruk opp materialet innen 90 sekunder etter blanding.
   Unit Dose: Kan ikke anvendes til denne bruk.
2. Påfør blandingen på den heftende flaten.
3. Tørk hele den heftende flaten godt med en mild luftstrøm i mer enn 5 sekunder til blandingen ikke beveger seg lenger. Bruk et sugeavtrekk for å forhindre at blandingen renner utover.
   [MERKNAD]
   For tilstrekkelig tørking må lufttrykket tilpasses den heftende flatens form og størrelse. For en optimal effekt påføres en silanbonding (f.eks. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS) i henhold til produsentens anvisninger på overflaten til glasskeramikken på silisiumdioksidbasis (f.eks. konvensjonelt porselen, litiumdisilikat) i stedet for blandingen.
4. Lysherd blandingen med en herdelampe (se tabell "Herdelampe og herdetid").
   [FORSIKTIG]
   Lysherdes blandingen ikke på den heftende flaten, forkortes bearbeidingstiden drastisk.

D-4. Forbehandling av tannen
Påfør K-ETCHANT Syringe om nødvendig. Se avsnitt A-4.

D-5. Bonding
Velg prosess avhengig av materialet som brukes.

D-5a. Ved bruk av PANAVIA SA Cement Plus

1. Umiddelbart før påføring has de nødvendige mengder BOND I fordypningen på dispensertallerkenen.
2. Masser BOND med applikatorbørsten inn i hele kavitetsveggen. Ventetid er ikke nødvendig.
   [MERKNAD]
   Påse at behandlingsoverflatene ikke kommer i berøring med spytt eller eksudat.
3. Tørk hele den heftende flaten godt med en mild luftstrøm i mer enn 5 sekunder til BOND ikke beveger seg lenger. Bruk et sugeavtrekk for å forhindre at BOND renner utover.
   [MERKNAD]
   For tilstrekkelig tørking må lufttrykket tilpasses den heftende flatens form og størrelse.

D-5b. Ved bruk av en annet dobbelt- eller selvherdende kunststoffsement

1. Ha en dråpe BOND og en dråpe "CLEARFIL DC Activator" i en fordypning på blandeplaten og bland med applikatorbørsten.
   [FORSIKTIG]
   Bruk den lysblokkerende platen, slik at materialet ikke utsettes for behandlingslys eller omgivelseslys, og bruk opp materialet innen 90 sekunder etter blanding.
2. Masser blandingen med applikatorbørsten inn i hele kavitetsveggen. Ventetid er ikke nødvendig.
   [MERKNAD]
   Påse at behandlingsoverflatene ikke kommer i berøring med spytt eller eksudat.
3. Tørk hele den heftende flaten godt med en mild luftstrøm i mer enn 5 sekunder til blandingen ikke beveger seg lenger. Bruk et sugeavtrekk for å forhindre at blandingen renner utover.
   [MERKNAD]
   For tilstrekkelig tørking må lufttrykket tilpasses den heftende flatens form og størrelse.
4. Lysherd blandingen med en herdelampe (se tabell "Herdelampe og herdetid").
   [FORSIKTIG]
   Lysherdes blandingen ikke på den heftende flaten, forkortes bearbeidingstiden drastisk.

D-6. Sementering
Sementer protesen med "PANAVIA SA Cement Plus" eller en annen kunststoffsement iht. anvisningen fra produsenten.
[MERKNAD]
Ved bruk av puls-herdemetoden ("Tack-Cure") forkortes herdetiden for overskytende sement. BOND eller blandingen av BOND og "CLEARFIL DC Activator" kan akselerere lysherdingen av sementen.

[GARANTI]
Kuraray Noritake Dental Inc. vil erstatte alle produkter som er bevist defekt. Kuraray Noritake Dental Inc. godtar ikke ansvar for tap eller skade, direkte, av konsekvens eller spesielt, som oppstår ved påføring eller bruk av eller manglende evne til å bruke disse produktene. Før bruk skal brukeren avgjøre egnetheten til produktene for tiltenkt bruk og brukeren påtar seg all risiko og ansvar i henhold til dette.

[MERKNAD]
"CLEARFIL", "CLEARFIL MAJESTY", "CLEARFIL ST", "CLEARFIL DC CORE PLUS", "PANAVIA" og "PANAVIA SA CEMENT"er varemerker av KURARAY CO., LTD.

Kuraray Noritake Dental Inc.
1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan

EC REP **Kuraray Europe GmbH**
Philipp-Reis-Str. 4,
65795 Hattersheim am Main, Germany
Phone:+49 (0)69 305 35 840 Fax:+49 (0)69 305 35 640

SUOMI KÄYTTÖOHJEET

I. JOHDANTO

"CLEARFIL Universal Bond" koostuu BOND-nesteestä ja K-ETCHANT Syringe-etsausaineesta. BOND on valokovetteinen sidosaine, jolla voidaan käsitellä samanaikaisesti dentiiniä, kiillettä ja proteesimateriaaleja. BOND-ainetta käytetään käyttöaiheen mukaan vaihdellen itse-etsautuvana tai K-ETCHANT Syringe-etsausaineen kanssa kiilteen selektiiviseen etsaukseen tai totaalietsaukseen. BOND-aine on tarkoitettu sekä suoraan että epäsuoraan paikkaukseen. "CLEARFIL DC Activator" aktivoi BOND-aineen kaksoiskovettumismekanismin. "CLEARFIL DC Activator" -aktivaattoria ei kuitenkaan tarvitse lisätä sidosaineeseen, jos sen kanssa käytetään "CLEARFIL DC CORE PLUS" tai "PANAVIA SA Cement Plus". BOND-ainetta on saatavana sekä Bottle- että Unit Dose -pakkauksissa. K-ETCHANT Syringe on etsausgeeli, joka koostuu fosforihapon 35 % vesiliuoksesta ja kolloidisesta piistä.

II. KÄYTTÖTARKOITUKSET

"CLEARFIL Universal Bond Quick" soveltuu käytettäväksi seuraavissa tapauksissa:

[1] Suora paikkaus valokovetteisella yhdistelmämuovilla
[2] Kaviteetin käsittely suorassa paikkaustekniikassa
[3] Paljastuneiden juuripintojen käsittely
[4] Yliherkkien hampaiden käsittely
[5] Murtuneiden restauraatioiden intraoraaliset korjaukset
[6] Nastan sementointi ja pilarin rakennus
[7] Epäsuorien restauraatioiden sementointi

III. KONTRAINDIKAATIOT

Potilaalla aiemmin todettu yliherkkyys metakrylaattimonomeereille ja tälle tuotteelle

IV. MAHDOLLISET SIVUVAIKUTUKSET

[1] Suun limakalvot saattavat muuttua valkeiksi BOND-aineen vaikutuksesta proteiinin hyytymisen vuoksi. Kyseessä on tilapäinen ilmiö, joka katoaa tavallisesti muutaman päivän sisällä. Potilasta on opastettava välttämään käsitellyn alueen ärsyttämistä harjauksen aikana.
[2] K-ETCHANT Syringe voi aiheuttaa ärsytystä kemiallisten ominaisuuksiensa vuoksi.

V. YHTEENSOPIMATTOMUUS

[1] Älkää käyttäkö pulpan suojaamisen tai väliaikaiseen täyttämiseen eugenolia sisältäviä materiaaleja, koska eugenoli saattaa hidastaa kovettumisprosessia.
[2] Älä käytä rautayhdisteitä sisältäviä verenvuodon tyrehdyttäjiä, sillä nämä aineet voivat heikentää kiinnittymistä ja aiheuttaa hampaan reunan tai ympäröivän ienalueen värjäytymistä. Tämä johtuu jäljelle jääneistä rautaioneista.
[3] Jos käytetään hemostaaseja jotka, sisältävää alumiinikloridia, määrä on minimoitava ja varottava, ettei tuote joudu kosketuksiin tartuntapinnan kanssa. Jos tuotetta pääsee tartuntapintaan, se heikentää sidoslujuutta.

VI. TURVATOIMENPITEET

1. Varotoimenpiteet

1. Tämä tuote sisältää aineita, jotka saattavat aiheuttaa allergisen reaktion. Älä käytä tuotetta potilailla, jotka ovat allergisia metakrylaattimonomeereille tai muille ainesosille.
2. Jos potilaalla syntyy yliherkkyysreaktio, esimerkiksi ihottuma, tulehduksen oireet, haavaumat, turvotus, kutina tai tunnottomuus, lopeta tuotteen käyttö ja ota yhteys lääkäriin.
3. Tuotteen käytössä on noudatettava varovaisuutta, ettei sitä joudu iholle tai silmä. Ennen käyttöä potilaan silmät on suojattava mahdollisilta roiskeilta peiteliinalla.
4. Jos tuotetta joutuu kosketuksiin ihmisen kudosten kanssa, toimi seuraavasti:
   < Jos tuotetta pääsee silmä >
   Huuhtele silmä välittömästi runsaalla vedellä ja ota yhteys lääkäriin.
   < Jos tuotetta pääsee iholle tai suun limakalvoille >
   Pyyhi välittömästi pois alkoholilla kostutetulla vanutupolla tai harsotaitoksella ja huuhtele runsaalla vedellä.
5. Ole varovainen, ettei potilas vahingossa niele tuotetta.
6. Vältä katsomasta suoraan kovetusvaloon BOND-tuotteen kovetuksen aikana.
7. Vältä saman sekoitusastian syvennykseen annostellun BOND-tuotteen ja saman Unit Dose -pakkauksen ja annosteluharjan käyttöä eri potilailla ristikontaminaation välttämiseksi. Unit Dose -pakkaus ja annosteluharja ovat kertakäyttöisiä. Hävitä ne käytön jälkeen. Neulakärki on kertakäyttöinen. Älä käytä sitä uudelleen ristikontaminaation välttämiseksi. Heitä se pois käytön jälkeen.
8. Käytä käsineitä tai huolehdi muista sopivista varotoimenpiteistä metakrylaattimonomeerien tai muiden ainesosien mahdollisesti aiheuttamien yliherkkyysreaktioiden estämiseksi.
9. Jos tämän tuotteen instrumentit vahingoittuvat, suojaa itseäsi vahingoittumiselta ja lopeta instrumenttien käyttö välittömästi.

2. Käsittelyyn ja muokkaukseen liittyvät varotoimenpiteet

【Yleiset varotoimenpiteet】

1. Tuotetta saa käyttää vain käyttötarkoituksiin, jotka on mainittu kohdassa [II.KÄYTTÖTARKOITUKSET].
2. Tuotetta saavat käyttää vain toimiluvan saaneet hammaslääketieteen ammattilaiset.
3. Käytä pulpansuoja-ainetta, jos kaviteetti on lähellä pulpaa tai jos pulpa paljastuu vahingossa.

【BOND】

1. BOND-aine sisältää etanolia, joka on herkästi syttyvää. Älä käytä avotulen läheisyydessä.
2. Noudata tarkoin ilmoitettuja valokovetusaikoja ja muita käsittelyvaatimuksia huonon laadun ja heikon käsiteltävyyden estämiseksi.
3. Puhdista kaviteetti huolellisesti, jotta sidos olisi vahva. Jos tartuntapinnalla on sylkeä tai verta, pese pinta huolellisesti ja kuivaa se ennen sidostamista.
4. **Bottle:** Käytä valonsuojalevyä, jotta materiaali ei altistu toimenpidevalolle tai ympäristövalolle, ja käytä sen työskentelyajan sisällä, joka on mainittu alla annostelun tai sekoituksen jälkeen:

Materiaali	Työskentelyaika
BOND	7 minuuttia
BOND + CLEARFIL DC Activator	90 s

Koska BOND-aineessa oleva etanoli haihtuu, viskositeetti lisääntyy, jolloin levitys on vaikeaa.
Unit Dose: Levitä BOND-ainetta annosteluharjalla heti säiliön kannen poistamisen jälkeen.

5. BOND-ainetta levitetään kiinnityspintaan hierovalla liikkeellä, poista kohdevalo suusta tai sammuta valo, jotta levitetty BOND-aine ei altistu toimenpidevalolle. Lisäksi pinta on kuivattava BOND-aineen levittämisen jälkeen puhaltamalla siihen ilmaa kevyesti, kunnes BOND-aine jähmettyy.
6. BOND sisältää etanolia ja vettä. "CLEARFIL DC Activator" sisältää etanolia. Kuivaa koko kiinnityspintaa riittävästi puhaltamalla siihen kevyesti ilmaa yli 5 sekunnin ajan, kunnes BOND-aine tai BOND-aineen ja "CLEARFIL DC Activator" -aineen sekoitus on jähmettynyt. Muutoin sidos on heikko. Jotta riittävä kuivaus on mahdollista, säädä ilmanpaine kaviteetin ja proteettisen työn muodon ja koon mukaisesti. Käytä tehoimua, jotta BOND-aine tai sekoitus ei leviä.
7. Jos käsitelty tartuntapinta on kontaminoitunut, huuhtele se vedellä ja kuivaa tai puhdista pinta alkoholilla ja käsittele se BOND-aineella uudelleen.
8. **Bottle:** Älä sekoita BOND-ainetta muihin sidosaineisiin, "CLEARFIL DC Activator" -ainetta lukuun ottamatta.
   Unit Dose: Älä sekoita BOND-ainetta muihin sidosaineisiin. Älä käytä Unit Dosea CLEARFIL DC Activatorin kanssa Unit Dose -säiliön mallista johtuen.
9. **Unit Dose:** Kun BOND-ainetta käytetään pilarin rakentamiseen tai sementoimiseen, käytä sitä vain seuraavien tuotteiden kanssa: "CLEARFIL DC CORE PLUS" tai "PANAVIA SA CEMENT Plus".
10. **Bottle:** Valokoveta sekoitus, jonka muodostavat BOND ja "CLEARFIL DC Activator". Muuten työskentelyaika lyhenee huomattavasti.
11. **Bottle:** Säilytysastia tulee sulkea tiukasti heti käytön jälkeen haihtuvan aineen (BOND-aine sisältää etanolia) haihtumisen estämiseksi. Jos neste ei virtaa suuttimesta helposti, älä pakota BOND-ainettä ulos tukkeutuneesta pakkauksesta.
12. **Bottle:** Jos BOND-aine ei valu kunnolla, koska BOND-tuotetta ei ole käytetty pitkään aikaan, ravistele säilytysastiaa ennen käyttöä.

【K-ETCHANT Syringe】

1. Varo likaamasta sitä syljellä ja verellä. Jos käsitelty pinta kontaminoituu, käsittele se uudelleen.
2. Varo ristikontaminaatiota. Desinfioi ruisku pyyhkimällä se alkoholilla kostutetulla vanulla ennen käyttöä ja käytön jälkeen. Peitä koko ruisku kertakäyttöisellä muovisuojalla, jotta aineen sekaan ei pääse sylkeä ja verta.
3. Jos tuotetta tarttuu vaatteisiin, pese se pois vedellä.
4. Poista neulakärki ruiskusta jokaisen käytön jälkeen ja kiinnitä välittömästi ruiskun korkki tiukasti.
5. Vitaalin hampaan dentiinin etsaaminen voi aiheuttaa toimenpiteen jälkeistä herkkyyttä.

【Valokovetin】

1. Valon matala intensiteetti heikentää sidosta. Tarkista lampun käyttöikä ja tarkista valokovettimen kärki kontaminaation varalta. Valokovettimen intensiteetti on suositeltavaa tarkistaa asianmukaisella valonarviointilaitteella säännöllisin väliajoin.
2. Valokovettimen emittoivaa kärkeä tulisi pitää mahdollisimman lähellä muovipintaa ja kohtisuorassa siihen nähden. Jos valokovetettava muovipinta on suuri, alue on suositeltavaa jakaa useiksi osa-alueiksi, jotka valokovetetaan erikseen.

3. Säilytystä koskevat varotoimenpiteet

1. Älä käytä tuotetta viimeisen käyttöpäiväyksen jälkeen. Viimeinen käyttöpäivä on merkitty pakkaukseen.
2. BOND-aine on säilytettävä jääkaapissa (2–8 °C/ 36-46 °F), kun sitä ei käytetä, ja sen on annettava lämmetä huoneenlämpötilaan 15 minuuttia ennen käyttöä. Erityisesti Bottle on jätettävä pystyasentoon kun se otetaan pois jääkaapista, kunnes se muuttuu huoneenlämpöiseksi. Muutoin nestettä saattaa tulla liikaa tai neste voi valua käytön jälkeen.
3. K-ETCHANT Syringe -geeli on säilytettävä 2 - 25°C/ 36 - 77°F lämpötilassa, kun sitä ei käytetä.
4. Ei saa säilyttää hyvin kuumassa paikassa, suorassa auringonvalossa tai tulen läheisyydessä.
5. Tuote on säilytettävä asianmukaisessa paikassa, johon vain hammaslääkintähenkilökunnalla on pääsy.

VII. SISÄLTÖ

Tuotteen sisältöä ja määrää koskevat tiedot pakkauksen ulkopuolella.
<Pääasialliset aineosat>

1) BOND
   - 10-Metakryyliyloyloxydecyl dihydrogeenifosfaatti
   - Bisfenoli-A-diglysidyylimetakrylaatti
   - 2-Hydroksietyylimetakrylaatti
   - Hydrofiiliset amidimonomeerit
   - Kolloidinen pii
   - Silaanikiinnitysaine
   - Natriumfluoridi
   - dl-Camphorquinone
   - Etanoli
   - Vesi

2) K-ETCHANT Syringe
   - Fosforihappo
   - Vesi
   - Kolloidinen pii
   - Pigmentti

3) Tarvikkeet
   - Applicator brush (fine <silver>) (Annosteluharja <kapea hopea>)
   - Dispensing dish (Sekoitusastia)
   - Light blocking plate (Valonsuojalevy)
   - Needle tip (E) (Neulakärki (E))

VIII. KLIINISET TOIMENPITEET

A. Toimenpide I

[1] Suora paikkaus valokovetteisella yhdistelmämuovilla
[2] Kaviteetin käsittely suorassa paikkaustekniikassa
[3] Paljastuneiden juuripintojen käsittely
[4] Yliherkkien hampaiden käsittely

A-1. Eristäminen ja kosteuden hallinta
Jotta tulos olisi mahdollimman hyvä, estä käsittelyalueen kontaminoituminen sylkeen tai vereen. Kofferdamin käyttöä suositellaan, jotta hammas pysyy puhtaana ja kuivana.

A-2. Kaviteetin tai juuripinnan valmistaminen
Poista infektoitunut dentiini ja valmista kaviteetti tavalliseen tapaan.
Kun käsitellään yliherkkiä hampaita, puhdista juuripinta totutulla tavalla. Puhdista sitten huolellisesti suihkuttamalla vettä ja kuivaa ilmalla tai vanutupoilla.

A-3. Pulpan suojaus
Pulpa tai pulpaa lähellä olevat alueet voidaan suojata kovettuvalla kalsiumhydroksidi-eristeellä. Vuoraus ei ole tarpeen. Älä käytä pulpan suojauksessa eugenolia sisältäviä aineita.

A-4. Hampaan esikäsittely
Valitse ennen BOND-tuotteen levittämistä jokin kolmesta etsausmenettelystä.
[HUOMAUTUS]
Kun käsitellään yliherkkiä hampaita, valitse seuraava A-4a ennen BOND-aineen levitystä.

A-4a. Itse-etsaustoimenpide
Siirry kohtaan A-5, jos etsaukseen ei käytetä K-ETCHANT Syringe -ruiskua.

A-4b. Valikoiva kiilteen etsaustoimenpide
Levitä K-ETCHANT Syringe käsittelemättömään ja/tai käsiteltyyn kiillepintaan. Anna sen vaikuttaa 10 sekunnin ajan, huuhtele ja kuivaa.

A-4c. Täysetsaustoimenpide
Levitä K-ETCHANT Syringe koko kaviteettiin (kiille ja dentiini), anna sen vaikuttaa 10 sekunnin ajan, huuhtele ja kuivaa.

A-5. BOND –sidosaineen levitys

1. **Bottle:** Annostele tarvittava määrä BOND -sidosainetta sekoitusmaljan syvennykseen välittömästi ennen käyttöä.
   [VAROITUS]
   Käytä valosuojalevyä, jotta lampun tai ympäristön valo ei koveta ainetta, ja käytä aine 7 minuutin kuluessa annostelusta.
   Unit Dose: Poista säiliön kansi.
   [VAROITUS]
   Älä kallista säiliötä kantta avattaessa, ettei BOND-ainetta läiky ulos.
2. Levitä BOND-aine annosteluharjalla hangaten koko kaviteetin seinämään. Odotusaikaa ei tarvita.
   [HUOMAUTUS]
   Varo ettei sylkeä tai eritettä pääse kosketuksiin käsiteltyjen pintojen kanssa.
3. Kuivaa koko kaviteetin seinämää riittävästi puhaltamalla siihen kevyesti ilmaa yli 5 sekunnin ajan, kunnes BOND-aine jähmettyy. Käytä imuria, jotta BOND-aine ei leviä.
4. Valokoveta BOND valokovettimella (ks. taulukko "Valokovetin ja kovetusaika").

Taulukko: Valokovetin ja kovetusaika

Malli	Valonlähde	Valoteho	Valokovetusaika
Halogeeni	Halogeenilamppu	Yli 400 mW/cm²	10 s
LED	Sininen LED*	800 – 1400 mW/cm²	10 s
		Yli 1500 mW/cm²	5 s

Kunkin valokovettimen tehollisen aallonpituusalueen on oltava 400–515 nm.
* Emissionspektrin huippu: 450 - 480 nm

A-6. Levitä yhdistelmämuovi tai käsittele yliherkät hampaat

A-6a. Suora paikkaus valokovetteisella yhdistelmämuovilla
Levitä kaviteettiin komposiittihartsi (esim. CLEARFIL MAJESTY ES-2, CLEARFIL MAJESTY ES Flow), valokoveta, viimeistele ja kiillota valmistajan ohjeiden mukaisesti.

A-6b. Kaviteetin käsittely ennen suoraa paikkausta
Levitä ohut kerros yhdistelmämuoveja (esim. CLEARFIL MAJESTY ES Flow) hampaalle, ja valokoveta valmistajan ohjeiden mukaisesti. Poista polymerisoitumaton resiini vanupallolla tai harsolla, joka on kostutettu alkoholiin.

A-6c. Yliherkkien hampaiden käsittely
Poista BONDin polymerisoitumaton kerros vanupallolla tai harsolla, joka on kostutettu alkoholissa.

B. Toimenpide II

[5] Murtuneiden restauraatioiden intraoraaliset korjaukset

B-1. Sidospintojen valmistelu
Karhenna kiinnityspinnat timanttikärjellä tai hiekkapuhalla niitä 30 - 50 µm alumiinioksidijauheella ilmanpaineen ollessa 0,1 - 0,4 MPa (14 - 58 PSI/ 1 - 4 kgf/cm²). Ilmanpaine on valittava proteesirestauraation materiaalin ja/tai muodon mukaan ja pinnan vaurioituminen on estettävä. Tee viiste reuna-alueelle.

B-2. Sidospintojen käsittely K-ETCHANT Syringe -ruiskulla
Levitä K-ETCHANT Syringe-etsausaine sidospinnalle (sis. hammasrakenteen).
Anna vaikuttaa 5 sekuntia, huuhtele ja kuivaa.

B-3. BONDin levittäminen
Levitä BOND-aine hieroen koko sidospinnalle. Katso osa A-5.
[HUOMAUTUS]
Parhaan sidostuksen varmistamiseksi levitä silaanisidosainetta (esim. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS) piipohjaisen lasikeramian (esim. perinteinen posliini, litiumdisilikaatti) pinnalle ja käytä jalometalleja sisältävälle pinnalle metallikiinnitysesikäsittelyainetta (esim. ALLOY PRIMER) valmistajan ohjeiden mukaisesti ENNEN BOND-aineen käyttöä.

B-4. Yhdistelmämuovin käyttö
Levitä kaviteettiin komposiittihartsi (esim. CLEARFIL MAJESTY ES-2), valokoveta, viimeistele ja kiillota valmistajan ohjeiden mukaisesti.
[HUOMAUTUS]
Käytä opaakkia yhdistelmämuovia (esim. CLEARFIL ST OPAQUER) metallivärin peittämiseen ennen komposiittihartsin asettamista.

C. Toimenpide III

[6] Nastan sementointi ja pilarin rakennus
Kun käytetään "CLEARFIL DC CORE PLUS" -tuotetta, "CLEARFIL DC Activator" -tuotteen käyttö ei ole tarpeen.

C-1. Eristäminen ja kosteuden hallinta
Jotta tulos olisi mahdollimman hyvä, estä käsittelyalueen kontaminoituminen sylkeen tai vereen. Kofferdamin käyttöä suositellaan, jotta hammas pysyy puhtaana ja kuivana.

C-2. Juurikanavan preparointi
Preparoi ja puhdista juurikanava avaus tavanomaiseen tapaan.

C-3. Nastan valmistelu
Valitse C-3a tai C-3b käyttämäsi nastan mukaan. Noudata restauraatiomateriaalin käyttöohjeita. Jos tarkkoja ohjeita ei ole, suosittelemme seuraavaa toimenpidettä:

C-3a. Lasikuitunastat

Levitä K-ETCHANT Syringe nastan pinnalle. Anna vaikuttaa 5 sekuntia, huuhtele ja kuivaa.

[VAROITUS]

- Älä hiekkapuhalla lasikuitunastoja alumiinioksidilla, koska ne voivat vahingoittua.
- Vältä käsiteltävien pintojen kaikenlaista kontaminaatiota esikäsittelyn aikana ja lopulliseen pilarin rakentamiseen saakka.

C-3b. Metallinastat

Karhenna kiinnityspinta hiekkapuhaltamalla sitä 30 - 50 µm alumiinioksidijauheella ilmanpaineen ollessa 0,2 - 0,4 MPa (29 - 58 PSI/ 2 - 4 kgf/cm²). Ilmanpaine on valittava materiaalin mukaan. Puhdista proteesirestauraatio hiekkapuhalluksen jälkeen käyttämällä ultraääntä 2 minuutin ajan. Kuivaa se sen jälkeen ilmavirralla.

C-4. Nastan pinnan käsittely

Valitse toimenpide käyttämäsi materiaalin mukaan.

C-4a. Kun käytät CLEARIFL DC CORE PLUS -tuotetta

1. Annostele tarvittava määrä BOND -sidosainetta sekoitusmaljan syvennykseen välittömästi ennen käyttöä.
2. Levitä annosteluharjalla BOND-ainetta koko nastan pintaan.
3. Kuivaa koko kiinnityspintaa riittävästi puhaltamalla siihen kevyesti ilmaa yli 5 sekunnin ajan, kunnes BOND-aine jähmettyy. Käytä imuria, jotta BOND-aine ei leviä.
   [HUOMAUTUS]
   Säädä ilmanpaine asianmukaista kuivaamista varten tartuntapinnan muodon ja koon mukaan.

C-4b. Käyttö muun kaksois-/kemialliskovetteisen resiinipilarimateriaalin tai kaksois-/kemialliskovetteisen resiinisementin kanssa

1. **Bottle:** Annostele yksi tippa sekä BOND-ainetta että ”CLEARFIL DC Activator” -ainetta sekoitusastian syvennykseen ja sekoita ne keskenään annosteluharjalla.
   [VAROITUS]
   Käytä valonsuojalevyä, jotta materiaali ei altistu toimenpidevalolle tai ympäristövalolle, ja käytä 90 sekunnin sisällä sekoituksesta.
   Unit Dose: Ei sovellu tähän käyttötarkoitukseen.
2. Levitä sekoitus nastan pintaan.
3. Kuivaa koko kiinnityspintaa riittävästi puhaltamalla siihen kevyesti ilmaa yli 5 sekunnin ajan, kunnes sekoitus jähmettyy. Käytä imuria, jotta sekoitus ei leviä.
   [HUOMAUTUS]
   Säädä ilmanpaine asianmukaista kuivaamista varten tartuntapinnan muodon ja koon mukaan.
4. Valokoveta sekoitus valokovettimen avulla (katso taulukko ”Valokovetin ja kovetusaika”).
   [VAROITUS]
   Työskentelyaika lyhenee huomattavasti, kun sekoitusta ei valokoveteta nastan päällä.

C-5. Hampaan esikäsittely

Käytä K-ETCHANT Syringe-etsausainetta tarpeen mukaan. Katso osa A-4.

C-6. Sidostus

Valitse toimenpide käytetyn materiaalin mukaan.

C-6a. Kun käytät CLEARIFL DC CORE PLUS -tuotetta

1. Annostele tarvittava määrä BOND -sidosainetta sekoitusmaljan syvennykseen välittömästi ennen käyttöä.
2. Levitä BOND-aine annosteluharjalla hieroen koko kaviteetin seinämään. Odotusaikaa ei tarvita.
   [HUOMAUTUS]
   Varo ettei sylkeä tai eritettä pääse kosketuksiin käsiteltyjen pintojen kanssa.
3. Kuivaa koko kiinnityspinta riittävästi puhaltamalla siihen kevyesti ilmaa yli 5 sekunnin ajan, kunnes BOND-aine jähmettyy. Käytä tehoimua, jotta BOND-aine ei roisku. Poista ylimääräinen BOND-aine paperinastalla. Kun ylimääräinen BOND-aine on pyyhitty pois, kuivaa kiinnityspinta uudelleen tarpeen vaatiessa.
   [HUOMAUTUS]
   Säädä ilmanpaine asianmukaista kuivaamista varten tartuntapinnan muodon ja koon mukaan.
4. Valokoveta BOND-ainetta valokovettimella (katso taulukko ”Valokovetin ja kovetusaika”).

C-6b. Käyttö muun kaksois-/kemialliskovetteisen resiinipilarimateriaalin tai kaksois-/kemialliskovetteisen resiinisementin kanssa

1. Annostele yksi tippa sekä BOND-ainetta että ”CLEARFIL DC Activator” -ainetta sekoitusastian syvennykseen ja sekoita ne keskenään annosteluharjalla.
   [VAROITUS]
   Käytä valonsuojalevyä, jotta materiaali ei altistu toimenpidevalolle tai ympäristövalolle, ja käytä 90 sekunnin sisällä sekoituksesta.
2. Levitä sekoitus annosteluharjalla hieroen koko kaviteetin seinämään. Odotusaikaa ei tarvita.
   [HUOMAUTUS]
   Varo ettei sylkeä tai eritettä pääse kosketuksiin käsiteltyjen pintojen kanssa.
3. Kuivaa koko kiinnityspinta riittävästi puhaltamalla siihen kevyesti ilmaa yli 5 sekunnin ajan, kunnes sekoitus jähmettyy. Käytä tehoimuria, jotta sekoitus ei roisku. Poista liika sekoitus paperinastalla. Kun olet pyyhkinyt liian sekoituksen pois, kuivaa kiinnityspinta uudelleen tarpeen vaatiessa.
   [HUOMAUTUS]
   Säädä ilmanpaine asianmukaista kuivaamista varten tartuntapinnan muodon ja koon mukaan.
4. Valokoveta sekoitusta valokovettimen avulla (katso taulukko ”Valokovetin ja kovetusaika”).
   [VAROITUS]
   Työskentelyaika lyhenee huomattavasti, kun sekoitusta ei valokoveteta juurikanavan päällä.

C-7. Nastan ja pilarin paikalleen asettaminen

Aseta nasta ja pilarirakenne paikoilleen käyttämällä ”CLEARFIL DC CORE PLUS” -tuotetta tai muuta resiinimateriaalia valmistajan ohjeiden mukaisesti.

D. Toimenpide IV

[7] Epäsuorien restauraatioiden sementointi

Kun käytetään ”PANAVIA SA Cement Plus” -tuotetta, ”CLEARFIL DC Activator” -tuotteen käyttö ei ole tarpeen.

D-1. Valmistele kaviteetin ja pilarin (hammas, metalli, yhdistelmämuovi) pinnat

1. Poista väliaikainen täytemateriaali ja -sementti tavanomaisella tavalla ja puhdista kaviteetti kosteuden määrää halliten.
2. Kokeile sopiiko proteesirestauraatio kaviteettiin tai pilariin (hammas, metalli, yhdistelmämuovi). Kun käytät kokeilupastaa värin tarkistamiseen, noudata valmistajan ohjeita.

D-2. Proteesirestauraation pinnan valmistaminen

Valitse käyttämäsi restauraation mukaan joko D-2a tai D-2b. Noudata restauraatiomateriaalin käyttöohjeita. Jos tarkkoja ohjeita ei ole saatavissa, suosittelemme seuraavaa toimenpidettä:

D-2a. Piipohjaiselle lasikeramiikalle (esim. perinteinen posliini, litiumdisilikaatti)

Etsaa lasikeraamiset pinnat fluorivetyihapolla valmistajan ohjeiden mukaisesti, pese ja kuivaa pinta huolellisesti.

D-2b. Metallioksideille (esim. zirkomiumoksidi), metalleille tai yhdistelmämuoveille

Karhenna kiinnityspinta hiekkapuhaltimella 30–50 µm:n alumiinioksidijauheella ilmanpaineella 0,2 - 0,4 MPa (29 - 58 PSI/ 2 - 4 kgf/cm²). Ilmanpaine on valittava proteesirestauraation materiaalin ja/tai muodon mukaan ja pinnan vaurioituminen on vältettävä. Puhdista proteesirestauraatio hiekkapuhalluksen jälkeen 2 minuutin ultraäänikäsittelyllä ja sen jälkeen ilmavirralla.

D-3. Proteesirestauraatioiden esikäsittely

Valitse toimenpide käyttämäsi materiaalin mukaan.

D-3a. Kun käytät PANAVIA SA Cement Plus -tuotetta

1. Annostele tarvittava määrä BOND -sidosainetta sekoitusmaljan syvennykseen välittömästi ennen käyttöä.
2. Levitä annosteluharjalla BOND-ainetta koko tartuntapintaan.
3. Kuivaa koko kiinnityspintaa riittävästi puhaltamalla siihen kevyesti ilmaa yli 5 sekunnin ajan, kunnes BOND-aine jähmettyy. Käytä tehoimua, jotta BOND-aine ei roisku.
   [HUOMAUTUS]
   - Säädä ilmanpaine asianmukaista kuivaamista varten tartuntapinnan muodon ja koon mukaan.
   - Levitä parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi silaanisidosainetta (esim. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS) piipohjaisen lasikeramian (esim. perinteinen posliini, litiumdisilikaatti) pinnalle BOND-aineen sijaan valmistajan ohjeiden mukaisesti. BOND-ainetta ei tarvitse käyttää metallioksidien tai metallien pinnalla, sillä ”PANAVIA SA Cement Plus” kiinnittyy tällaisiin pintoihin voimakkaasti.

D-3b. Käyttö muun kaksois- tai kemialliskovetteisen resiinisementin kanssa

1. **Bottle:** Annostele yksi tippa sekä BOND-ainetta että ”CLEARFIL DC Activator” -ainetta sekoitusastian syvennykseen ja sekoita ne keskenään annosteluharjalla.
   [VAROITUS]
   Käytä valonsuojalevyä, jotta materiaali ei altistu toimenpidevalolle tai ympäristövalolle, ja käytä 90 sekunnin sisällä sekoituksesta.
   Unit Dose: Ei sovellu tähän käyttötarkoitukseen.
2. Levitä sekoitus tartuntapintaan.
3. Kuivaa koko kiinnityspintaa riittävästi puhaltamalla siihen kevyesti ilmaa yli 5 sekunnin ajan, kunnes sekoitus jähmettyy. Käytä tehoimua, jotta sekoitus ei roisku.
   [HUOMAUTUS]
   Säädä ilmanpaine asianmukaista kuivaamista varten tartuntapinnan muodon ja koon mukaan. Levitä parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi silaanisidosainetta (esim. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS) piipohjaisen lasikeraamin (esim. perinteinen posliini, litiumdisilikaatti) pinnalle sekoituksen sijaan valmistajan ohjeiden mukaisesti.
4. Valokoveta sekoitusta valokovettimen avulla (katso taulukko ”Valokovetin ja kovetusaika”).
   [VAROITUS]
   Työskentelyaika lyhenee huomattavasti, kun kiinnityspinnalle laitettua sekoitusta ei valokoveteta.

D-4. Hampaan esikäsittely

Levitä K-ETCHANT Syringe tarpeen mukaan. Katso osa A-4.

D-5. Sidostus

Valitse toimenpide käytetyn materiaalin mukaan.

D-5a. Kun käytät PANAVIA SA Cement Plus -tuotetta

1. Annostele tarvittava määrä BOND -sidosainetta sekoitusmaljan syvennykseen välittömästi ennen käyttöä.
2. Levitä BOND-aine annosteluharjalla hieroen koko kaviteetin seinämään. Odotusaikaa ei tarvita.
   [HUOMAUTUS]
   Varo ettei sylkeä tai eritettä pääse kosketuksiin käsiteltyjen pintojen kanssa.
3. Kuivaa koko kiinnityspintaa riittävästi puhaltamalla siihen kevyesti ilmaa yli 5 sekunnin ajan, kunnes BOND-aine jähmettyy. Käytä tehoimua, jotta BOND-aine ei roisku.
   [HUOMAUTUS]
   Säädä ilmanpaine asianmukaista kuivaamista varten tartuntapinnan muodon ja koon mukaan.

D-5b. Käyttö muun kaksois- tai kemialliskovetteisen resiinisementin kanssa

1. Annostele yksi tippa sekä BOND-ainetta että ”CLEARFIL DC Activator” -ainetta sekoitusastian syvennykseen ja sekoita ne keskenään annosteluharjalla.
   [VAROITUS]
   Käytä valonsuojalevyä, jotta materiaali ei altistu toimenpidevalolle tai ympäristövalolle, ja käytä 90 sekunnin sisällä sekoituksesta.
2. Levitä sekoitus annosteluharjalla hieroen koko kaviteetin seinämään. Odotusaikaa ei tarvita.
   [HUOMAUTUS]
   Varo ettei sylkeä tai eritettä pääse kosketuksiin käsiteltyjen pintojen kanssa.
3. Kuivaa koko kiinnityspintaa riittävästi puhaltamalla siihen kevyesti ilmaa yli 5 sekunnin ajan, kunnes sekoitus jähmettyy. Käytä tehoimua, jotta sekoitus ei roisku.
   [HUOMAUTUS]
   Säädä ilmanpaine asianmukaista kuivaamista varten tartuntapinnan muodon ja koon mukaan.
4. Valokoveta sekoitusta valokovettimen avulla (katso taulukko ”Valokovetin ja kovetusaika”).
   [VAROITUS]
   Työskentelyaika lyhenee huomattavasti, kun kiinnityspinnalle laitettua sekoitusta ei valokoveteta.

D-6. Sementointi

Sementoi proteesirestauraatio käyttämällä ”PANAVIA SA Cement Plus” -ainetta tai muuta resiinisementtiä valmistajan ohjeiden mukaisesti.

[HUOMAUTUS]

Osittainen valokovetus (”Tack-Cure”) nopeuttaa ylimääräisen sementin kovettumista. BOND tai BOND-aineen ja ”CLEARFIL DC Activator” -aktivaattorin sekoitus saattaa nopeuttaa sementin valokovettumista.

[TAKUU]

Kuraray Noritake Dental Inc. vaihtaa kaikki virheelliseksi todetut tuotteet. Kuraray Noritake Dental Inc. ei ota vastuuta vahingoista tai vaurioista, jotka ovat joko suoraan tai epäsuorasti syntyneet yrityksen tuotteiden käytön tai virheellisen käytön johdosta. Ennen tuotteen käyttöönottoa on käyttäjän varmistuttava, soveltuuko tuote siihen käyttötarkoitukseen, johon sitä aiotaan käyttää ja käyttää kantaa kaiken tuotteen käyttöön liittyvän riskin ja vastuun.

[HUOMAUTUS]

"CLEARFIL", "CLEARFIL MAJESTY", "CLEARFIL ST", "CLEARFIL DC CORE PLUS", "PANAVIA" ja "PANAVIA SA CEMENT" ovat KURARAY CO., LTD:n tavaramerkkejä.

Kuraray Noritake Dental Inc.
1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan

EC REP Kuraray Europe GmbH
Philipp-Reis-Str. 4,
65795 Hattersheim am Main, Germany
Phone:+49 (0)69 305 35 840 Fax:+49 (0)69 305 35 640

DANSK BRUGSANVISNING

I. INTRODUKTION

”CLEARFIL Universal Bond Quick” består af BOND og K-ETCHANT Syringe. BOND er et lyshærdende bonding-system, der tillader samtidig behandling af dentin, emalje og protetik. Afhængigt af indikationen anvendes BOND som selvætsende eller med K-ETCHANT Syringe til den selektive emaljeætsnings- eller total-etch procedure. BOND er beregnet til anvendelse til både direkte og indirekte restaureringer. ”CLEARFIL DC Activator” aktiverer den dualhærdende mekanisme i BOND; tilføjelsen af ”CLEARFIL DC Activator” til adhæsivet er dog ikke påkrævet ved anvendelse med ”CLEARFIL DC CORE PLUS” eller ”PANAVIA SA Cement Plus”.
BOND fås både som Bottle og Unit Dose dispenseringssystem. K-ETCHANT Syringe er en ætsningsgel, der består af 35 % phosphorsyre i vandig opløsning samt kolloidal silica.

II. INDIKATIONER

"CLEARFIL Universal Bond Quick" er beregnet til følgende indikationer:
[1] Direkte restaureringer ved anvendelse af lyshærdende kompositplast
[2] Kavitetsforsegling som forbehandling til indirekte restaureringer
[3] Behandling af blottede rodoverflader
[4] Behandling af hypersensitive tænder
[5] Intraorale reparationer af frakturerede restaureringer
[6] Stift-cementering og plastopbygninger
[7] Cementering af indirekte restaureringer

III. KONTRAINDIKATIONER

Patienter med overfølsomhed over for methacrylat-monomerer og dette produkt

IV. MULIGE BIVIRKNINGER

[1] På grund af proteinkoagulation kan mundens slimhinder blive hvide, hvis de kommer i kontakt med BOND. Dette er et forbigående fænomen, som normalt forsvinder i løbet af nogle få dage. Informer patienten om, hvordan man undgår irritation af de berørte områder ved tandbørstning.
[2] K-ETCHANT Syringe kan på grund af dens kemi forårsage inflammation eller erosion.

V. INKOMPATIBILITETER

[1] Der bør ikke anvendes materialer, der indeholder eugenol, til beskyttelse af pulpa eller provisoriske fyldninger, da eugenol kan forsinke hærdningsprocessen.
[2] Der bør ikke anvendes ikke hæmostatiske midler, der indeholder jernforbindelser, da disse materialer på grund af jernindholdet kan svække adhæsionen og forårsage misfarvning af tandkødsranden eller den omliggende gingiva.
[3] Hvis der anvendes hæmostatika, der indeholder aluminiumklorid, bør mængden minimeres. Undgå kontakt med den adhærerende overflade. Manglende overholdelse heraf kan reducere bonding-styrken til tandstrukturen.

VI. FORHOLDSREGLER

1. Sikkerhedsforanstaltninger

1. Dette produkt indeholder stoffer, der kan fremkalde allergiske reaktioner. Undgå at anvende produktet hos patienter med kendt overfølsomhed over for methacrylat-monomerer eller andre komponenter.
2. Hvis patienten udviser overfølsomhedsreaktioner, som fx udslet, eksem, inflammationer, sår, hævelser, kløe eller følelsesløshed, skal anvendelsen af produktet ophøre, fjern produktet og en læge konsulteres.
3. Udvis forsigtighed ved anvendelsen af produktet, så det ikke kommer i berøring med huden eller øjnene. Inden produktet anvendes, bør patientens øjne tildækkes med en serviet eller lignende som beskyttelse mod stænk fra materialet.
4. Hvis produktet kommer i berøring med kropsvæv, skal der træffes følgende forholdsregler:
   < Hvis produktet kommer i øjet >
   Skyl omgående øjet med rigelige mængder vand og søg læge.
   < Hvis produktet kommer i berøring med huden eller orale slimhinder >
   Fjern omgående produktet ved hjælp af en vattampon eller gaze, der er fugtet med alkohol, og skyl med rigelige mængder vand.
5. Pas på, at patienten ikke ved en fejltagelse sluger produktet.
6. Undgå at se direkte ind i polymeriseringslampen under polymerisering af BOND.
7. For at undgå krydskontaminationer bør det undgås, at samme BOND (der er dispenseret i fordybningen på dispenseringspladen), samt Unit Dose og appliceringspensel ikke anvendes til andre patienter. Unit Dose og appliceringspensel er beregnet til engangsbrug. Bortskaf dem efter anvendelsen. Nåle-tipen er kun til engangsbrug. Genbrug ikke nåle-tipen, så krydskontamination undgås. Bortskaf nåle-tipen efter brug.
8. For at forhindre forekomsten af overfølsomhed, der fremkaldes af kontakt med methacrylsyreester monomer eller andre komponenter, bør du bære handsker eller tage andre beskyttende forholdsregler.
9. Hvis instrumenterne i dette produkt er beskadigede, skal man af hensyn til personlig sikkerhed straks ophøre med at anvende dem.

2. Forholdsregler ved håndtering

【Generelle forholdsregler】

1. Produktet må ikke anvendes til andre formål, end dem, der er specificeret under [II.INDIKATIONER].
2. Anvendelsen af dette produkt er udelukkende forbeholdt autoriserede tandlæger.
3. Anvend et pulpabeskyttende materiale i en kavitet tæt ved pulpa eller i tilfælde af en blottet pulpa.

【BOND】

1. BOND indeholder ethanol, som er en brændbar substans. Må ikke anvendes i nærheden af åben ild.
2. For at forebygge dårlig behandling og håndtering bør de angivne lyshærdningstider samt øvrige krav til håndteringen nøje overholdes.
3. Rengør kaviteten omhyggeligt, så en dårlig bonding undgås. Hvis den adhærerende overflade er kontamineret med spyt eller blod, skylles den grundigt og tørres inden bonding.
4. **Bottle:** Anvend en lysblokerende plade for at undgå, at materialet udsættes for operationslys eller det omgivende lys, og anvend det inden for den neden for anførte arbejdstid efter dispensering eller blanding.

Materiale	Arbejdstid
BOND	7 minutter
BOND + CLEARFIL DC Activator	90 sek.

Hvis ethanolet i BOND fordamper, øges viskositeten, hvilket vanskeliggør appliceringen af produktet.
Unit Dose: Applicer BOND ved hjælp af appliceringspenslen, og umiddelbart efter at hætten på beholderen er åbnet.

5. Under applicering af BOND på den adhærerende overflade ved hjælp af indmasseringen skal lyskilden flyttes ud af munden eller lyset helt slukkes, så det applicerede BOND undgår at blive påvirket af operationslyset. Efter applicering af BOND skal der desuden tørres omhyggeligt ved hjælp af en mild luftstrøm, indtil BOND ikke længere bevæger sig.
6. BOND indeholder ethanol og vand. ”CLEARFIL DC Activator” indeholder ethanol. Tør hele den adhærerende overflade omhyggeligt i over 5 sekunder ved hjælp af en mild luftstrøm, indtil BOND eller blandingen af BOND og ”CLEARFIL DC Activator” ikke længere bevæger sig. I modsat fald vil adhæsionenseffekten blive svækket. For en tilstrækkelig tørring skal lufttrykket justeres efter kavitetens form og størrelse samt den protetiske anordning. Anvend et vakuum-sug for at hindre BOND eller blandingen i at sprede sig.
7. Hvis den behandlede flade kontamineres, skylles den med vand og tørres eller rengøres med alkohol, hvorefter behandlingen med BOND gentages.
8. **Bottle:** Bland ikke BOND med andre bonding-materialer end ”CLEARFIL DC Activator”.
   Unit Dose: Bland ikke BOND med andre bondings-materialer. Anvend ikke Unit Dose til CLEARFIL DC Activator grundet designet af Unit Dose-beholderen.
9. **Unit Dose:** Ved anvendelse til kerneopbygninger eller cementering bruges BOND udelukkende med ”CLEARFIL DC CORE PLUS” eller ”PANAVIA SA CEMENT Plus”.
10. **Bottle:** Foretag en lyshærdning af blandingen af BOND og ”CLEARFIL DC Activator”. Ellers forkortes arbejdstiden dramatisk.
11. **Bottle:** For at reducere fordampningen af det flygtige stof (BOND indeholder ethanol), skal beholderen straks efter anvendelsen lukkes omhyggeligt. Hvis væsken ikke flyder problemløst ud af spidsen, brug ikke unødig kraft for at dispensere BOND fra en blokeret beholder.
12. **Bottle:** Hvis BOND ikke har været anvendt i en længere periode, kan det forekomme, at det ikke mere er så letflydende. I så fald rystes beholderen inden anvendelsen.

【K-ETCHANT Syringe】

1. Undgå omhyggeligt at kontaminere med spyt eller blod. Hvis den behandlede overflade er kontamineret, behandles på ny.
2. Undgå omhyggeligt krydskontaminationer. Foretag en desinfektion af sprøjten ved både før og efter anvendelsen at aftørre den med absorberende vat, der er vædet med alkohol. Dæk hele sprøjten med et engangs-plastikovertræk for at hindre kontamination med spyt og blod.
3. Hvis produktet hænger fast på tøjet, fjernes det med vand.
4. Fjern nåle-tipen fra sprøjten efter hver anvendelse og sæt straks igen hætten på sprøjten.
5. Ætsning af vital dentin kan forårsage postoperativ overfølsomhed.

【Hærdelampe】

1. Lav lysintensitet medfører dårlig adhæsion. Kontrollér, om lampen trænger til serviceeftersyn, samt at hærdelampens guide-spids ikke er forurenet. Det anbefales, at hærdelampens intensitet med passende intervaller kontrolleres ved hjælp af et relevant kontrolapparat.
2. Hærdelampens lysudgang skal holdes vertikalt og så tæt på resinoverfladen, som muligt. Hvis det er en større resinoverflade, der skal lyshærdes, anbefales det, at man opdeler området i flere sektioner og lyshærder hver enkelt sektion separat.

3. Forholdsregler vedrørende opbevaring

1. Produktet skal anvendes inden den udløbsdato, der fremgår af emballagen.
2. BOND skal opbevares i køleskab (2-8°C/ 36-46°F), hvis det ikke er i brug, og opbevares ved stuetemperatur i 15 minutter inden anvendelsen. Specielt Bottle skal, efter at det er taget ud af køleskabet, henstå, indtil det har opnået stuetemperatur. I modsat fald er der risiko for, at der dispenseres for meget væske, eller at denne siver ud efter anvendelsen.
3. K-ETCHANT Syringe skal opbevares ved 2 - 25°C/ 36 - 77°F, når det ikke er i brug.
4. Produktet må ikke udsættes for ekstrem varme, direkte sollys eller åben ild.
5. Produktet skal opbevares på et forsvarligt sted, til hvilket kun tandlægepersonalet har adgang.

VII. KOMPONENTER

Se venligst ydersiden af emballagen vedrørende indhold og mængde.
<Hovedbestanddele>

1) BOND
- 10-Methacryloyloxydecyl dihydrogen-fosfat
- Bisphenol-A diglycidylmethacrylat
- 2-Hydroxyethylmethacrylat
- Hydrofile amid monomerer
- Kolloidal silica
- Silan-primer
- Natriumfluorid
- dl-Camphorquinon
- Ethanol
- Vand

2) K-ETCHANT Syringe
- Phosphorsyre
- Vand
- Kolloidal silica
- Pigment

3) Tilbehør
- Applicator brush (fine <silver>) (Appliceringspensel <fin sølv>)
- Dispensing dish (Dispenseringsplade)
- Light blocking plate (Lysblokerende plade)
- Needle tip (E) (Nåle-tip (E))

VIII. KLINISKE PROCEDURER

A. Standardprocedure I

[1] Direkte restaureringer ved anvendelse af lyshærdende kompositplast
[2] Kavitetsforsegling som forbehandling til indirekte restaureringer
[3] Behandling af blottede rodoverflader
[4] Behandling af hypersensitive tænder

A-1. Isolering og tørlægning

For at opnå optimale resultater, skal enhver kontamination af kaviteten med spyt og andre tilsmudsninger undgås. Vi anbefaler en kofferdam for at holde tanden ren og tør.

A-2. Præparation af kavitet eller rodoverflader

Fjern den syge dentin helt og forbered kaviteten på sædvanlig måde.
Ved behandling af hypersensitive tænder rengøres rodoverfladen på sædvanlig måde. Skyl derefter grundigt med vandspray og tør med luft eller vatpellets.

A-3. Pulpabeskyttelse

Områder i kaviteten, der befinder sig tæt på pulpa, bør dækkes med et hårdtafbindende calciumhydroxid-materiale. Det er ikke nødvendigt at anvende
en cementlining eller -base. Anvend ikke eugenolmaterialer til pulpabeskyttelse.

A-4. Forbehandling af tand

Vælg en af de tre ætsningsprocedurer inden applicering af BOND.

[BEMÆRK]

Ved behandling af hypersensitive tænder: Vælg nedenstående A-4a inden applicering af BOND.

A-4a. Selvætsende procedure

Fortsæt med sektion A-5 uden at ætse med K-ETCHANT Syringe.

A-4b. Selektiv emaljeætsnings-procedure

Applicér K-ETCHANT Syringe på den uslebne og/eller slebne emalje. Lad den sidde på stedet i 10 sekunder, hvorefter der skylles og tørres.

A-4c. Totalætsnings-procedure

Applicér K-ETCHANT Syringe på hele kaviteten (emalje og dentin). Lad den sidde på stedet i 10 sekunder, hvorefter der skylles og tørres.

A-5. Applicering af BOND

1. **Bottle:** Dispensér den nødvendige mængde BOND i fordybningen på dispenseringspladen umiddelbart inden appliceringen.
   [ADVARSEL]
   Anvend en lysblokerende plade for at undgå, at materialet udsættes for operationslys eller det omgivende lys, og anvend det inden for 7 minutter efter dispenseringen.
   Unit Dose: Fjern hætten fra beholderen.
   [ADVARSEL]
   Undgå at vippe beholderen, når hætten tages af, for ikke at spilde BOND.
2. Applicér BOND på hele kavitetsvæggen, idet det masseres ind ved hjælp af appliceringspenslen. Ventetid er ikke nødvendig.
   [BEMÆRK]
   Undgå, at spyt eller ekssudat kommer i kontakt med de behandlede overflader.
3. Tør hele kavitetsvæggen omhyggeligt i over 5 sekunder ved hjælp af en mild luftstrøm, indtil BOND ikke længere bevæger sig. Anvend et vakuum-sug for at hindre BOND i at sprede sig.
4. Polymerisér BOND med en hærdelampe (se tabellen “Hærdelampe og hærdningstid”).

Tabel: Hærdelampe og hærdningstid

Type	Lyskilde	Lysintensitet	Lyshærdningstid
Halogen	Halogenlampe	Over 400 mW/cm²	10 sek.
LED	Blå LED*	800 – 1400 mW/cm²	10 sek.
		Over 1500 mW/cm²	5 sek.

Det effektive bølgelængdeområde for hver hærdelanpe skal være 400-515 nm.
* Emisionsspektrets topværdi: 450 - 480 nm

A-6. Anbringelse af kompositresin som restaurering eller behandling af hypersensitive tænder

A-6a. Direkte restaureringer ved anvendelse af lyshærdende kompositplast

Anbring komposit (fx CLEARFIL MAJESTY ES-2, CLEARFIL MAJESTY ES Flow) i kaviteten og foretag en polymerisation, finishering og polering i henhold til producentens vejledninger.

A-6b. Kavitetsforsegling og behandling af blottede rodoverflader

Anbring et tyndt lag kompositplast (fx CLEARFIL MAJESTY ES Flow) på tanden og foretag en lyspolymerisation i henhold til producentens instruktioner. Fjern upolymeriseret plast med vatpellets eller gaze, der er fugtet med alkohol.

A-6c. Behandling af hypersensitive tænder

Fjern det upolymeriserede lag af BOND med en vatpellet eller gaze, vædet med alkohol.

B. Standardprocedure II

[5] Intraorale reparationer af frakturerede restaureringer

B-1. Præparation af adhærerende overflader

Gør den adhærerende overflade ru ved hjælp af en diamantspids eller blæs med 30 til 50 µm aluminiumspulver og et lufttryk på 0,1-0,4 MPa (14-58 PSI/ 1-4 kgf/cm²). Lufttrykket skal omhyggeligt justeres, så det passer til materialet og/eller den protetiske restaurerings form. Der bør udvises forsigtighed, så skader undgås. Lav en bevel i kantområdet.

B-2. K-ETCHANT Syringe behandling af adhærerende overflader

Applicér K-ETCHANT Syringe på den adhærerende overflade (inklusiv tandstrukturen). Lad den sidde på stedet i 5 sekunder, hvorefter der skylles og tørres.

B-3. Applicering af BOND

Applicér BOND på hele den adhærerende overflade, idet det masseres ind. Se sektion A-5.

[BEMÆRK]

Med henblik på et optimalt resultat appliceres en silan-primer (fx CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS) på overfladen af den silikatbaserede glaskeramik (fx konventionelt porcelæn, lithium disilikat), og applicér en metal-adhæsiv primer (fx ALLOY PRIMER) på overflader, der omfatter ædelmetal, i henhold til producentens instruktioner, INDEN der appliceres BOND.

B-4. Applicering af kompositplast, restaurering

Anbring komposit (fx CLEARFIL MAJESTY ES-2) i kaviteten og foretag en polymerisation, finishering og polering i henhold til producentens vejledninger.

[BEMÆRK]

Anvend en opak resin (fx CLEARFIL ST OPAQUER) inden anbringelsen af kompositresin, så metalfarven dækkes.

C. Standardprocedure III

[6] Stift-cementering og plastopbygninger

Ved anvendelse sammen med ”CLEARFIL DC CORE PLUS” er brugen af ”CLEARFIL DC Activator” ikke nødvendig.

C-1. Isolering og tørlægning

For at opnå optimale resultater, skal enhver kontamination af kaviteten med spyt og andre tilsmudsninger undgås. Vi anbefaler en kofferdam for at holde tanden ren og tør.

C-2. Præparering af rodkanal

Præparér og rengør rodkanalens åbning på sædvanlig vis.

C-3. Præparering af stift

Vælg enten C-3a eller C-3b - alt efter den anvendte stift. Følg venligst brugsanvisningen til restaureringsmaterialet. Ved manglende specifikke instruktioner anbefales følgende procedure:

C-3a. Glasfiberstifter

Applicér K-ETCHANT Syringe på stiftens overflade. Lad den sidde på stedet i 5 sekunder, hvorefter der skylles og tørres.

[ADVARSEL]

- Sandblæs ikke glasfiberstifter med aluminiumspulver. I modsat fald kan stiften blive beskadiget.
- Undgå enhver kontamination af de overflader, der skal behandles, under forbehandlingen og til den endelige kerneopbygning.

C-3b. Metalstifter

Gør den adhærerende overflade ru ved at blæse med 30 til 50 µm aluminiumspulver og et lufttryk på 0,2-0,4 MPa (29-58 PSI/ 2-4 kgf/cm²). Lufttrykket skal nøje justeres i forhold til materialet. Efter sandblæsningen rengøres den protetiske restaurering ved hjælp af ultralyd i 2 minutter, hvorefter der tørres med luftspray.

C-4. Behandling af stiftoverflade

Vælg procedure alt efter anvendt materiale.

C-4a. Ved anvendelse med CLEARIFL DC CORE PLUS

1. Dispensér den nødvendige mængde BOND i fordybningen på dispenseringspladen umiddelbart inden appliceringen.
2. Applicér BOND på hele stiftens overflade ved hjælp af appliceringspenslen.
3. Tør hele den adhærerende overflade omhyggeligt i over 5 sekunder ved hjælp af en mild luftstrøm, indtil BOND ikke længere bevæger sig. Anvend et vakuum-sug for at hindre BOND i at sprede sig.
   [BEMÆRK]
   For at opnå en omhyggelig tørring bør lufttrykket tilpasses den adhærerende overflades form og størrelse.

C-4b. Ved anvendelse med andet dual-/selvhærdende plast-kernemateriale eller en dual-/selvhærdende plastcement

1. **Bottle:** Dispensér en dråbe af hhv. BOND og ”CLEARFIL DC Activator” i en fordybning på blandingspladen og bland dem med appliceringspenslen.
   [ADVARSEL]
   Anvend en lysblokerende plade for at undgå, at materialet udsættes for operationslys eller det omgivende lys, og anvend det inden for 90 sekunder efter blanding.
   Unit Dose: Ikke anvendelig til dette formål.
2. Applicér blandingen på stiftens overflade.
3. Tør hele den adhærerende overflade omhyggeligt i over 5 sekunder ved hjælp af en mild luftstrøm, indtil blandingen ikke længere bevæger sig. Anvend et vakuum-sug for at hindre blandingen i at sprede sig.
   [BEMÆRK]
   For at opnå en omhyggelig tørring bør lufttrykket tilpasses den adhærerende overflades form og størrelse.
4. Lyspolymerisér blandingen med en hærdelampe (se tabellen ”Hærdelampe og hærdningstid”).
   [ADVARSEL]
   Arbejdstiden forkortes dramatisk, hvis der ikke foretages en lyspolymerisation af blandingen på stiften.

C-5. Forbehandling af tand

Applicér K-ETCHANT Syringe efter behov. Se sektion A-4.

C-6. Bonding

Vælg procedure alt efter anvendt materiale.

C-6a. Ved anvendelse med CLEARIFL DC CORE PLUS

1. Dispensér den nødvendige mængde BOND i fordybningen på dispenseringspladen umiddelbart inden appliceringen.
2. Applicér BOND på hele kavitetsvæggen, idet det masseres ind ved hjælp af appliceringspenslen. Ventetid er ikke nødvendig.
   [BEMÆRK]
   Undgå, at spyt eller ekssudat kommer i kontakt med de behandlede overflader.
3. Tør hele den adhærerende overflade omhyggeligt i over 5 sekunder ved hjælp af en mild luftstrøm, indtil BOND ikke længere bevæger sig. Anvend et vakuum-sug for at hindre BOND i at sprede sig. Fjern overskydende BOND med en paper point. Efter fjernelsen af overskydende BOND skal den adhærerende overflade eventuelt tørres igen.
   [BEMÆRK]
   For at opnå en omhyggelig tørring bør lufttrykket tilpasses den adhærerende overflades form og størrelse.
4. Lyspolymerisér BOND med en hærdelampe (se tabellen ”Hærdelampe og hærdningstid”).

C-6b. Ved anvendelse med andet dual-/selvhærdende plast-kernemateriale eller en dual-/selvhærdende plastcement

1. Dispensér en dråbe af hhv. BOND og ”CLEARFIL DC Activator” i en fordybning på blandingspladen og bland dem med appliceringspenslen.
   [ADVARSEL]
   Anvend en lysblokerende plade for at undgå, at materialet udsættes for operationslys eller det omgivende lys, og anvend det inden for 90 sekunder efter blanding.
2. Applicér blandingen på hele kavitetsvæggen, idet det masseres ind ved hjælp af appliceringspenslen. Ventetid er ikke nødvendig.
   [BEMÆRK]
   Undgå, at spyt eller ekssudat kommer i kontakt med de behandlede overflader.
3. Tør hele den adhærerende overflade omhyggeligt i over 5 sekunder ved hjælp af en mild luftstrøm, indtil blandingen ikke længere bevæger sig. Anvend et vakuum-sug for at hindre blandingen i at sprede sig. Fjern overskydende blanding med en paper point. Efter fjernelsen af den overskydende blanding skal den adhærerende overflade eventuelt tørres igen.
   [BEMÆRK]
   For at opnå en omhyggelig tørring bør lufttrykket tilpasses den adhærerende overflades form og størrelse.
4. Lyspolymerisér blandingen med en hærdelampe (se tabellen ”Hærdelampe og hærdningstid”).
   [ADVARSEL]
   Arbejdstiden forkortes dramatisk, hvis der ikke foretages en lyspolymerisation af blandingen på rodkanalen.

C-7. Anbringelse af stift og kernopbygning

Anbring stift og kerneopbygning ved anvendelse af ”CLEARFIL DC CORE PLUS” eller andet plastmateriale i henhold til producentens instruktioner.

D. Standardprocedure IV

[7] Cementering af indirekte restaureringer

Ved anvendelse sammen med ”PANAVIA SA Cement Plus” er brugen af ”CLEARFIL DC Activator” ikke nødvendig.

D-1. Konditionering af kavitets- og opbygnings- (tand, metal,komposit) overflader

1. Fjern det provisoriske forseglingsmateriale samt provisorisk cement på normal vis. Rengør kaviteten og sørg for tørlægning.
2. Indprøv den protetiske restaurering for at kontrollere, at den passer til kavitet eller opbygning (tand, metal, komposit). Ved anvendelse af en indprøvningspasta til kontrol af farven bør producentens instruktioner følges.

D-2. Overfladepræparation af protetiske restaureringer

Vælg enten D-2a eller D-2b - alt efter den anvendte restaurering. Følg venligst brugsanvisningen vedrørende restaureringsmaterialet. Ved manglende specifikke instruktioner anbefales følgende procedure:

D-2a. Silikatbaseret karamik (fx konventionelt porcelæn, lithium disilikat)

Æts glaskeramikoverflader med flussyre i henhold til producentens instruktioner. Skyl og tør overfladen omhyggeligt.

D-2b. Metaloxider (fx zirkonia), metaller eller kompositplast

Gør den adhærerende overflade ru ved hjælp af blæsning med 30 til 50 µm aluminiumspulver og et lufttryk på 0,2-0,4 MPa (29-58 PSI/ 2-4 kgf/cm²). Lufttrykket skal omhyggeligt justeres, så det passer til materialet og/eller den protetiske restaurering form; der bør udvises forsigtighed, så skader undgås. Efter blæsningen rengøres den protetiske restaurering ved hjælp af ultralyd i 2 minutter, hvorefter der tørres med luftspray.

D-3. Forbehandling af protetiske restaureringer

Vælg procedure alt efter anvendt materiale.

D-3a. Ved anvendelse med PANAVIA SA Cement Plus

1. Dispensér den nødvendige mængde BOND i fordybningen på dispenseringspladen umiddelbart inden appliceringen.
2. Applicér BOND på hele den adhærerende overflade ved hjælp af appliceringspenslen.
3. Tør hele den adhærerende overflade omhyggeligt i over 5 sekunder ved hjælp af en mild luftstrøm, indtil BOND ikke længere bevæger sig. Anvend et vakuum-sug for at hindre BOND i at sprede sig.
   [BEMÆRK]
   - For at opnå en omhyggelig tørring bør lufttrykket tilpasses den adhærerende overflades form og størrelse.
   - Med henblik på et optimalt resultat appliceres en silan-primer (fx CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS) på overfladen af den silikatbaserede glaskeramik (fx konventionelt porcelæn, lithium disilikat) i stedet for BOND, i henhold til producentens instruktioner. Applicering af BOND på metaloxider eller metaller er ikke nødvendig, da ”PANAVIA SA Cement Plus” hæfter godt på disse overflader.

D-3b. Ved anvendelse med anden dual- eller selvhærdende plastcement

1. **Bottle:** Dispensér en dråbe af hhv. BOND og ”CLEARFIL DC Activator” i en fordybning på blandingspladen og bland dem med appliceringspenslen.
   [ADVARSEL]
   Anvend en lysblokerende plade for at undgå, at materialet udsættes for operationslys eller det omgivende lys, og anvend det inden for 90 sekunder efter blanding.
   Unit Dose: Ikke anvendelig til dette formål.
2. Applicér blandingen på den adherærende overflade.
3. Tør hele den adhærerende overflade omhyggeligt i over 5 sekunder ved hjælp af en mild luftstrøm, indtil blandingen ikke længere bevæger sig. Anvend et vakuum-sug for at hindre blandingen i at sprede sig.
   [BEMÆRK]
   For at opnå en omhyggelig tørring bør lufttrykket tilpasses den adhærerende overflades form og størrelse. Med henblik på et optimalt resultat appliceres en silan-primer (fx CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS) på overfladen af den silikatbaserede glaskeramik (fx konventionelt porcelæn, lithium disilikat) i stedet for blandingen, i henhold til producentens instruktioner.
4. Lyspolymerisér blandingen med en hærdelampe (se tabellen ”Hærdelampe og hærdningstid”).
   [ADVARSEL]
   Arbejdstiden forkortes dramatisk, hvis der ikke foretages en lyspolymerisation af blandingen på den adhærerende overflade.

D-4. Forbehandling af tand

Om nødvendigt, appliceres K-ETCHANT Syringe. Se sektion A-4.

D-5. Bonding

Vælg procedure alt efter anvendt materiale.

D-5a. Ved anvendelse med PANAVIA SA Cement Plus

1. Dispensér den nødvendige mængde BOND i fordybningen på dispenseringspladen umiddelbart inden appliceringen.
2. Applicér BOND på hele kavitetsvæggen, idet det masseres ind ved hjælp af appliceringspenslen. Ventetid er ikke nødvendig.
   [BEMÆRK]
   Undgå, at spyt eller ekssudat kommer i kontakt med de behandlede overflader.
3. Tør hele den adhærerende overflade omhyggeligt i over 5 sekunder ved hjælp af en mild luftstrøm, indtil BOND ikke længere bevæger sig. Anvend et vakuum-sug for at hindre BOND i at sprede sig.
   [BEMÆRK]
   For at opnå en omhyggelig tørring bør lufttrykket tilpasses den adhærerende overflades form og størrelse.

D-5b. Ved anvendelse med anden dual- eller selvhærdende plastcement

1. Dispensér en dråbe af hhv. BOND og ”CLEARFIL DC Activator” i en fordybning på blandingspladen og bland dem med appliceringspenslen.
   [ADVARSEL]
   Anvend en lysblokerende plade for at undgå, at materialet udsættes for operationslys eller det omgivende lys, og anvend det inden for 90 sekunder efter blanding.
2. Applicér blandingen på hele kavitetsvæggen, idet det masseres ind ved hjælp af appliceringspenslen. Ventetid er ikke nødvendig.
   [BEMÆRK]
   Undgå, at spyt eller ekssudat kommer i kontakt med de behandlede overflader.
3. Tør hele den adhærerende overflade omhyggeligt i over 5 sekunder ved hjælp af en mild luftstrøm, indtil blandingen ikke længere bevæger sig. Anvend et vakuum-sug for at hindre blandingen i at sprede sig.
   [BEMÆRK]
   For at opnå en omhyggelig tørring bør lufttrykket tilpasses den adhærerende overflades form og størrelse.
4. Lyspolymerisér blandingen med en hærdelampe (se tabellen ”Hærdelampe og hærdningstid”).
   [ADVARSEL]
   Arbejdstiden forkortes dramatisk, hvis der ikke foretages en lyspolymerisation af blandingen på den adhærerende overflade.

D-6. Cementering

Cementér den protetiske restaurering ved hjælp af ”PANAVIA SA Cement Plus” eller anden plastcement i henhold til producentens instruktioner.

[BEMÆRK]

Ved anvendelse af en partiel lyshærdningsteknik (eller ”Tack-Cure”) vil afbindingstiden for den overskydende cement blive hurtigere. BOND eller blandingen af BOND med ”CLEARFIL DC Activator” kan accelerere lyshædningstiden for cementen.

[GARANTI]

Kuraray Noritake Dental Inc. erstatter ethvert produkt, der beviseligt er defekt. Kuraray Noritake Dental Inc. påtager sig intet ansvar for noget tab eller skader, det være sig direkte skader, følgeskader eller specielle skader, der er opstået ved appliceringen eller som følge af brugerens manglende kendskab til anvendelsen af disse produkter. Inden anvendelsen skal brugeren vurdere produktets egnethed til den pågældende opgave, ligesom brugeren skal påtage sig alle risici og et hvilket som helst ansvar i forbindelse hermed.

[BEMÆRK]

"CLEARFIL", "CLEARFIL MAJESTY", "CLEARFIL ST", "CLEARFIL DC CORE PLUS", "PANAVIA" og "PANAVIA SA CEMENT" er varemærker af KURARAY CO., LTD.

Kuraray Noritake Dental Inc.
1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan

EC REP Kuraray Europe GmbH
Philipp-Reis-Str. 4,
65795 Hattersheim am Main, Germany
Phone:+49 (0)69 305 35 840 Fax:+49 (0)69 305 35 640

001 1562R768R-EU3 05/2016

1562R768R-EU3 ura 420×594mm